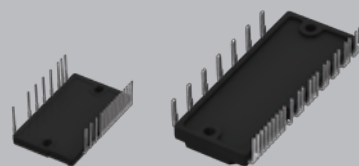


## 最适合用于空调、变频器、伺服系统的新一代 IPM

富士电机开发出了最适合用于大型空调、工业用变频器和伺服系统的 Small IPM ( Intelligent Power Module )<sup>※1</sup>。本产品通过采用第 7 代 X 系列的 IGBT 芯片技术，大幅降低了功耗，并利用高耐热封装技术，提高了最高操作结温，使对象设备的节能化和小型化成为可能。

※1：IPM 是一个内置了三相变频器桥式电路、控制电路和保护电路的模块。

- 通过运用第 7 代 IGBT 技术，实现了低功耗，提高了节能性
- 通过提高过电流、过热保护功能的精度，扩大输出能力
- 利用了高散热铝绝缘基板的超小型 DIP 封装



封装：P633A、P642

用途示例：空调、伺服系统放大器、工业用变频器等

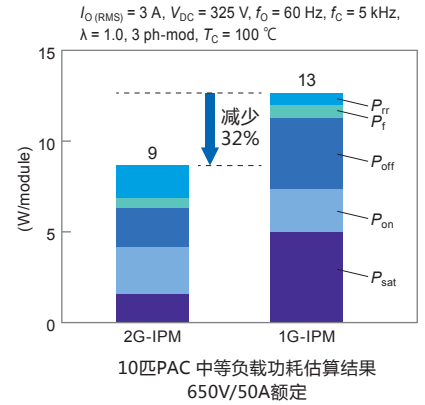
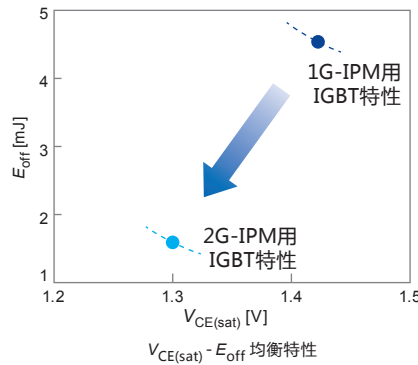
# 1. 运用第7代IGBT技术实现低功耗

运用最新的第7代IGBT技术,改善  
 $V_{CE(sat)} - SW$ 功耗均衡特性



与旧型产品相比,  
变频器工作在中等负载时功耗减小32%  
**APF性能提升!**

## 相比旧型产品



# 2. 利用了高散热铝绝缘基板的小型DIP封装

采用在绝缘层中使用树脂的  
高散热铝绝缘基板



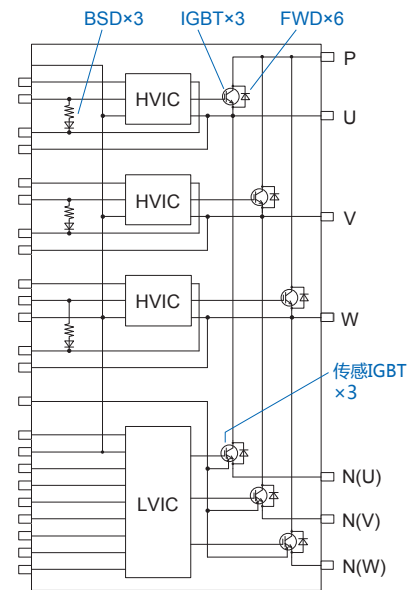
将最高操作结温 ( $T_{vjop}$ ) 从  
125°C提高至150°C

	P642	P633A
	79 (W) × 31 (D) × 8 (模块厚度) mm	43 (W) × 26 (D) × 3.7 (模块厚度) mm

## 产品系列表

$V_{CE}$ (V)	型号	$I_c$ (A)	$V_{CE(sat)}$ typ. (V)	$V_f$ typ. (V)	过热保护功能	封装	保证动作范围
650	6MBP50XTA065-50	50	1.30	1.55	无	P642	$T_{vjop} \leq 150^\circ C$
	6MBP50XTC065-50				有		
	6MBP75XTA065-50	75	1.35	1.60	无		
	6MBP75XTC065-50				有		
600	6MBP15XSD060-50	15	1.60	1.60	无	P633A	
	6MBP15XSF060-50				有		
	6MBP20XSD060-50	20	1.60	1.70	无		
	6MBP20XSF060-50				有		
	6MBP30XSD060-50	30	1.70	1.70	无		
	6MBP30XSF060-50				有		
	6MBP35XSD060-50	35	1.40	1.70	无		
	6MBP35XSF060-50				有		

## 内部等效电路: P642



### 安全相关注意事项

- \*使用前请仔细阅读“使用说明书”和“规格书”或咨询本公司或您购买产品的店铺后适当使用。
- \*请委托拥有本领域专业技术的人员进行处理。

## 富士电机株式会社

URL [www.fujielectric.com/products/semiconductor/cn/](http://www.fujielectric.com/products/semiconductor/cn/)  
Gate City Ohsaki, East Tower, 1-11-2, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan Tel: +81-3-5435-7156

- 富士电机(中国)有限公司 上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座26楼 Tel: +86-21-5496-1177
- 富士电机(香港)有限公司 九龍旺角太子道西193號新世紀廣場第二座16字樓1601-1603及05室 Tel: +852-2664-8699
- 台湾富士电机股份有限公司 10459台北市中山區松江路168號10樓 Tel: +886-2-2511-1820

2021-8 FOLS PDF

本文档的内容如有更改,恕不另行通知。